

SOLDER BALLS LF SENZA PIOMBO SN96.5/AG3/CU0.5 (9 FORMATI)



Cod. SBLF



SFERE DI STAGNO IN LEGA SN/AG/CU

Solder Balls senza piombo per BGA Reballing disponibili in nove diversi diametri.

Composizione lega: **Sn96.5/Ag3/Cu0.5** - Lead-Free.

Confezioni da **250.000 pezzi**.

Formati disponibili (Diametro sfera): 0.25mm - 0.30mm - 0.35mm - 0.40mm - 0.45mm - 0.50mm - 0.55mm - 0.60mm - 0.76mm

Categoria principale >> [Prodotti per saldatura a stagno](#)

VARIABILI DI PRODOTTO

Cod.	Descr.	Diametro
071958C	Solder Balls LF senza piombo in lega SnAgCu (Ø 0,25mm)	0,25 mm
071958D	Solder Balls LF senza piombo in lega SnAgCu (Ø 0,30mm)	0,30 mm



Cod.	Descr.	Diametro
071958E	Solder Balls LF senza piombo in lega SnAgCu (Ø 0,35mm)	0,35 mm
071958F	Solder Balls LF senza piombo in lega SnAgCu (Ø 0,40mm)	0,40 mm
071958G	Solder Balls LF senza piombo in lega SnAgCu (Ø 0,45mm)	0,45 mm
071958H	Solder Balls LF senza piombo in lega SnAgCu (Ø 0,50mm)	0,50 mm
071958I	Solder Balls LF senza piombo in lega SnAgCu (Ø 0,55mm)	0,55 mm
071958L	Solder Balls LF senza piombo in lega SnAgCu (Ø 0,60mm)	0,60 mm
071958B	Solder Balls LF senza piombo in lega SnAgCu (Ø 0,76mm)	0,76 mm